

IPC-Flex DC



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

IPC-Flex DC Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet	
	Abmessung (BxTxH)	277x252x 140 mm	
	Gewicht	Ca. 3,5 kg	
DETAILS	CPU	Intel® Core™ i7 6700, 3,4Ghz	
	Chipsatz	Intel® Q170	
	Speicher	8GB DDR4	
	Grafik	Intel® HD Graphics 530	
	Laufwerke	1x 128GB SSD	
	LAN	2x GbE (Intel® i211, i219LM)	
	Kühlung	Passiv	
	Erweiterungsslots	1x PCIe x8	
		2x PCIe x4	
		1x Mini PCIe Full Size	
Front I/O	1x DP		
	4x USB 3.0		
	2x RJ45		
	2x DSUB9 (RS232)		
	4x DIO		
	Taster / LED		
	DC IN Stromversorgung 9-36V; 16A (Phoenix DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08)		
Rear I/O	Staubfilter		
UMWELTBEDINGUNGEN	Operating	Storage	
	Temperatur	0-45° C	-10-70° C
	Luftfeuchtigkeit	10-80 %	10-95 %

DB_IPC-Flex_DC_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten

IPC-Flex DC

Dimensionen (in mm)

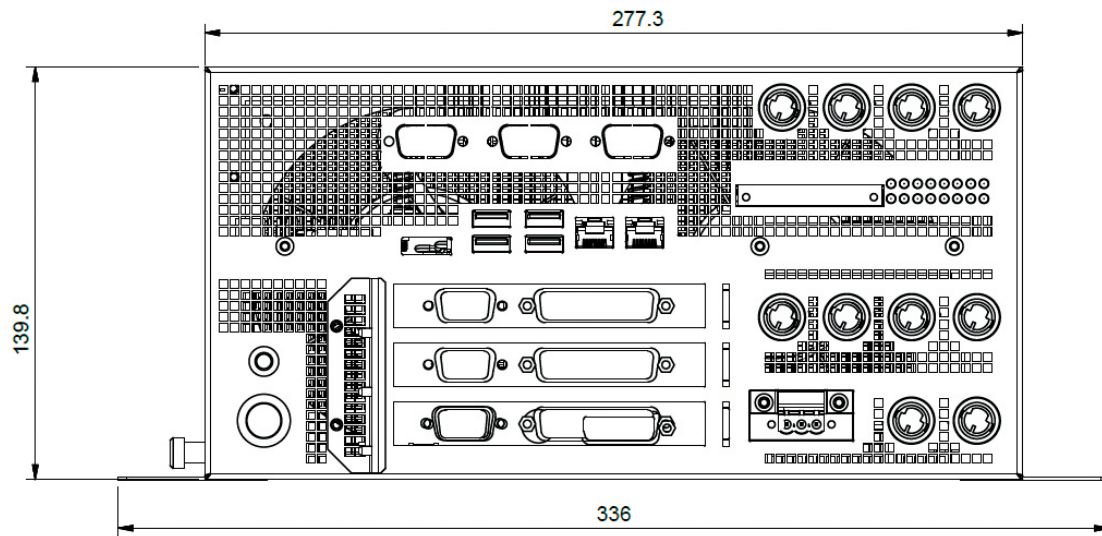
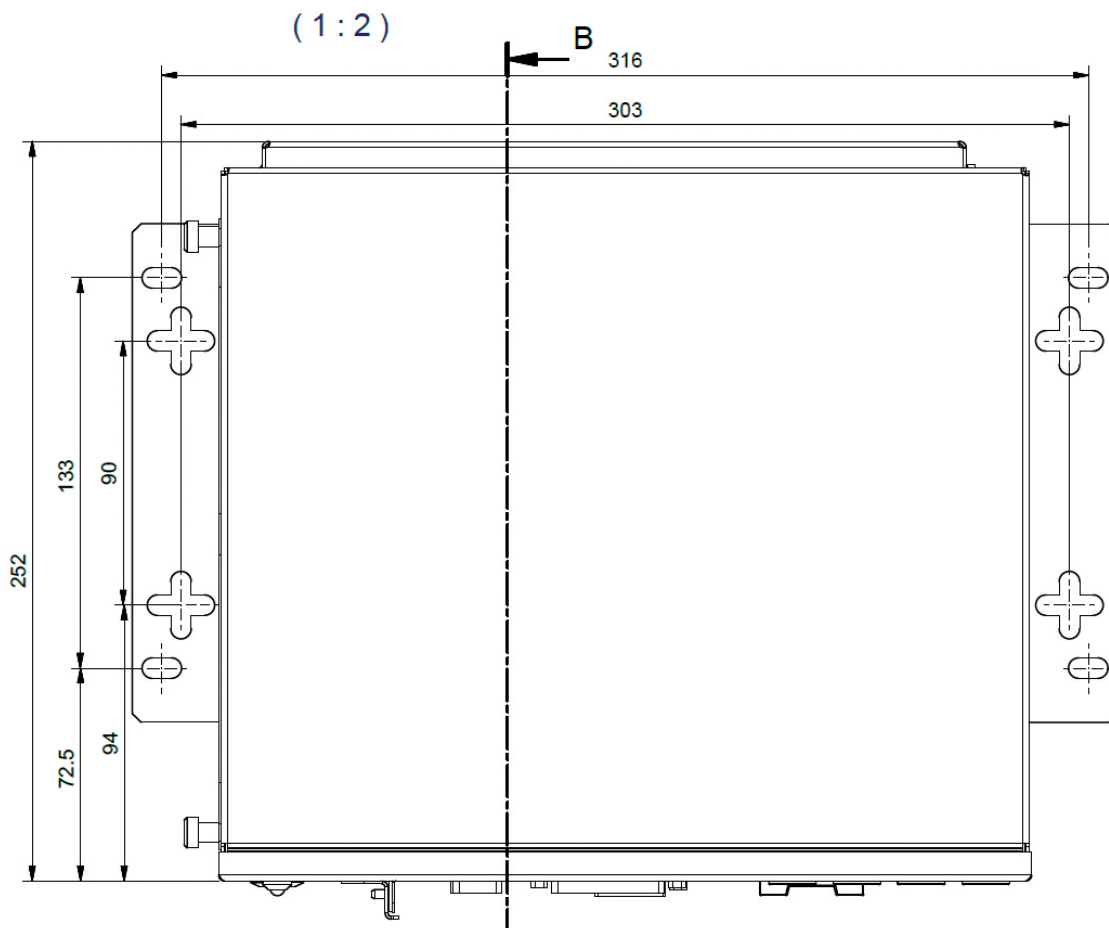


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante



DB_IPC-Flex_DC_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten